

Photonics Systems GmbH  
Pionierstrasse 6  
82152 Krailling

T +49(89) 8105 9168-0  
F +49(89) 8105 9168-1900  
E sales@ps-group.net

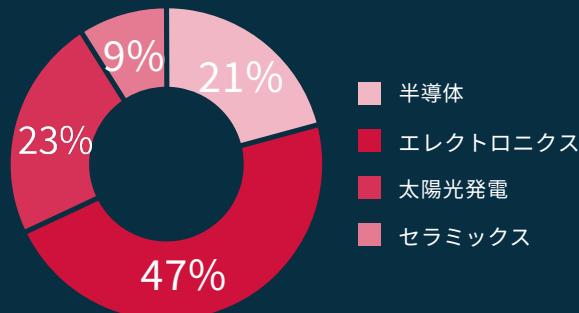


日本正規代理店  
ワールドリンク合同会社  
大阪府池田市旭丘 1-4-7

T\_072-736-9959  
F\_072-736-9965  
E\_info@worldlink-jp.com



## 市場シェア内訳



## 用途分野



## 次世代レーザー デバネリング DP10XX

リジッド・フレックス両対応 PCBA 用多用途レーザーデバネリングプラットフォーム



## 特長

- 最先端レーザー製造装置
- 24 時間 365 日稼働対応
- 導入しやすいトータルハンドリングソリューション
- MES とのカスタム連携
- 自動車業界で認められたレーザープロセス
- リジッド・フレキシブル両方の基板材料に対応
- 資材効率の最適化

## 注目ポイント

- 応力や切りくずの発生しないレーザー加工
- 炭化なしで高精度・高品質なカット
- 最大パネルサイズ 18 x 18 インチ
- 幅広いレーザー発振器オプション
- 第 2 加工ヘッド搭載



デュアルヘッド仕様



全自動ハンドリング

PSGは30年以上の豊富な経験を持ち、レーザー微細加工、自動化、検査装置分野において業界をリードするパイオニアです。



世界中で提供されるプロフェッショナルなサポートとサービスにより、常にお客様のそばで24時間365日対応します。



専用製品ラインナップと高品質なプロダクトで、所有コストを最小限に。自動化や検査によるアップグレードも可能です。

### デバイス IC フロントエンド



ウェファートリム  
WT35XX シリーズ



ウェファーフューズ  
WF10XX シリーズ



サーキットトリム  
LT50XX シリーズ



カスタマイズ  
PIPOCAPIPOCA シリーズ

### PCB IC パッケージング



ドリル加工・ルーティング  
DR20XX シリーズ



ドリル加工・ルーティング  
DR30XX シリーズ  
大型基板対応

### セラミックス



切断・穴あけ加工  
CR20XX シリーズ

### SMT 組立



基板分割  
DP10XX シリーズ

### 太陽光発電



コンタクト開口 ULTAGO  
プラットフォーム



レーザーエッジ削除  
DIMENSO プラットフォーム



セルカット (LDC)  
Lumion プラットフォーム

## STANDARD SPECIFICATIONS

	DP1010	DP1020	DP1030	DP1040
				
Laser Type	green Nanosecond	green Nanosecond	green Nanosecond	green Nanosecond
Wavelength	532 nm	532 nm	532 nm	532 nm
Average Laser Power	up to 48 W	up to 48 W	up to 48 W	up to 48 W
Laser Power Measurement	Integrated Automatic	Integrated Automatic	Integrated Automatic	Integrated Automatic
Max. Panel Size Single Head	460 mm x 500 mm	305 mm x 460 mm	305 mm x 460 mm	305 mm x 460 mm
Max. Panel Size Dual Head	2x(230 mm x 305 mm)	2x(230 mm x 305 mm)	2x(230 mm x 305 mm)	2x(230 mm x 305 mm)
Accuracy	<± 25 µm	<± 25 µm	<± 25 µm	<± 25 µm
Vision System	5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.
Upstream Interface	SMEMA	SMEMA	SMEMA	SMEMA
Downstream Interface	SMEMA	SMEMA	SMEMA/EtherCAT	SMEMA
Workpiece Carrier Handling	Manual	Automatic	Automatic	Automatic
Workpiece Carrier Cleaning	Manual	Automatic	Automatic	Automatic
Output Finished Parts	Manual / Semi-Automatic	JEDEC Feeder	Customized Shuttle Feeder	Customized Tray Feeder

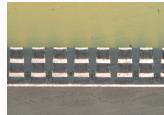
PSG は、エレクトロニクス製造分野において、お客様のバリューチェーン全体にわたる多彩な工程をご提供します

IC フロントエンド



SiCウェーハ分割

IC パッケージング



ICパッケージ穴あけ

PCB 製造



プリント基板穴あけ

デバイス製造

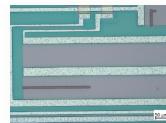


回路トリミング

SMT 組立



PCB 分割処理



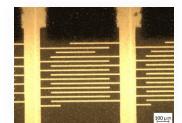
ウェーハトリミング



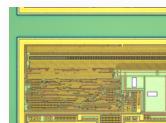
ウェーハダイシング



フレックス基板カット



ChipR トリミング



レーザー融合



セラミック基板の  
切断・穴あけ



DCB/AMB  
のスクライ  
ビング・ド  
リリング

## 企業概要

ドイツ発のレーザー機器メーカー：自動化・検査・プロービング分野に特化。

実績ある研究開発力：ラボから大量生産まで対応するスケーラブルなソリューション。

一流企業との取引実績：世界的メガトレンドに沿った多様な市場にサービスを提供。

グローバルサポート：アジアと北米の拠点が24時間365日サポートを実現。



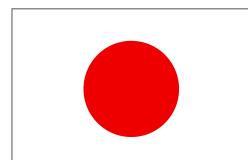
## 主要データ

- 世界中で 2900 台以上のシステム導入実績
- 本社所在地：ドイツ・ミュンヘン
- 従業員数：150 名

## お問い合わせ

グローバルサポート：アジアと北米の拠点が週 7 日 X 24 時間サポートを実現

日本正規代理店：ワールドリンク合同会社  
大阪府池田市旭丘 1-4-7  
TEL : 072-736-9959  
FAX : 072-736-9965  
[info@worldlink-jp.com](mailto:info@worldlink-jp.com)  
[www.worldlink-jp.com](http://www.worldlink-jp.com)



Photonics Systems GmbH  
Pionierstrasse 6  
82152 Krailling  
[www.photonics-systems-group.com](http://www.photonics-systems-group.com)

# Laser depaneling of populated PCBs

## 実装済み基板の レーザー分割技術

Photonics Systems Group は、電子・半導体分野における最先端の高品質ソリューションを提供する業界のリーディングカンパニーです。

